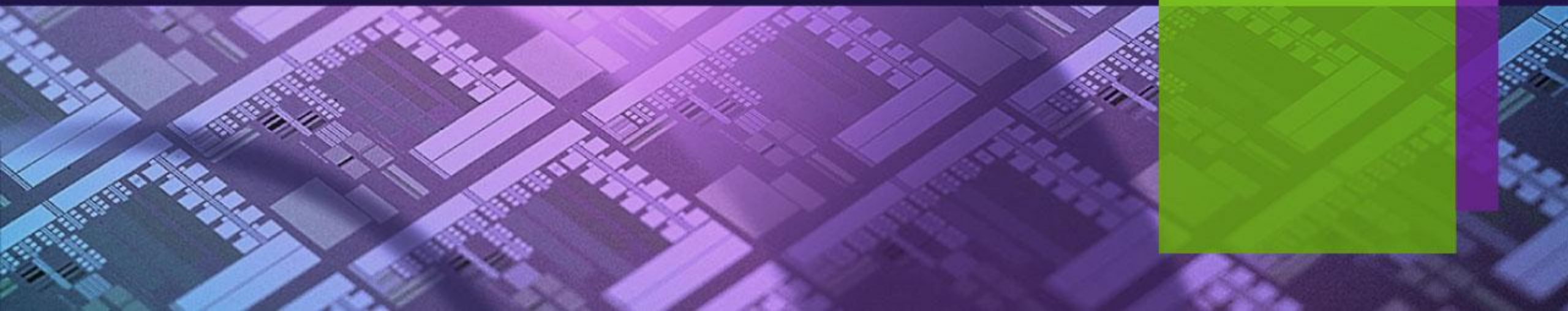


2027年3月期 第2四半期（2026年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2026年10月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員・CFO）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替変動について

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれており、一部に外貨建の売上および費用計上があります。各国・地域における経済環境、国際情勢、金利変動等の要因により、急激な為替変動があった場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2027年3月期 第2四半期 連結決算の概要

2026年10月30日

常務執行役員・CFO
川本 弘



損益状況（四半期）

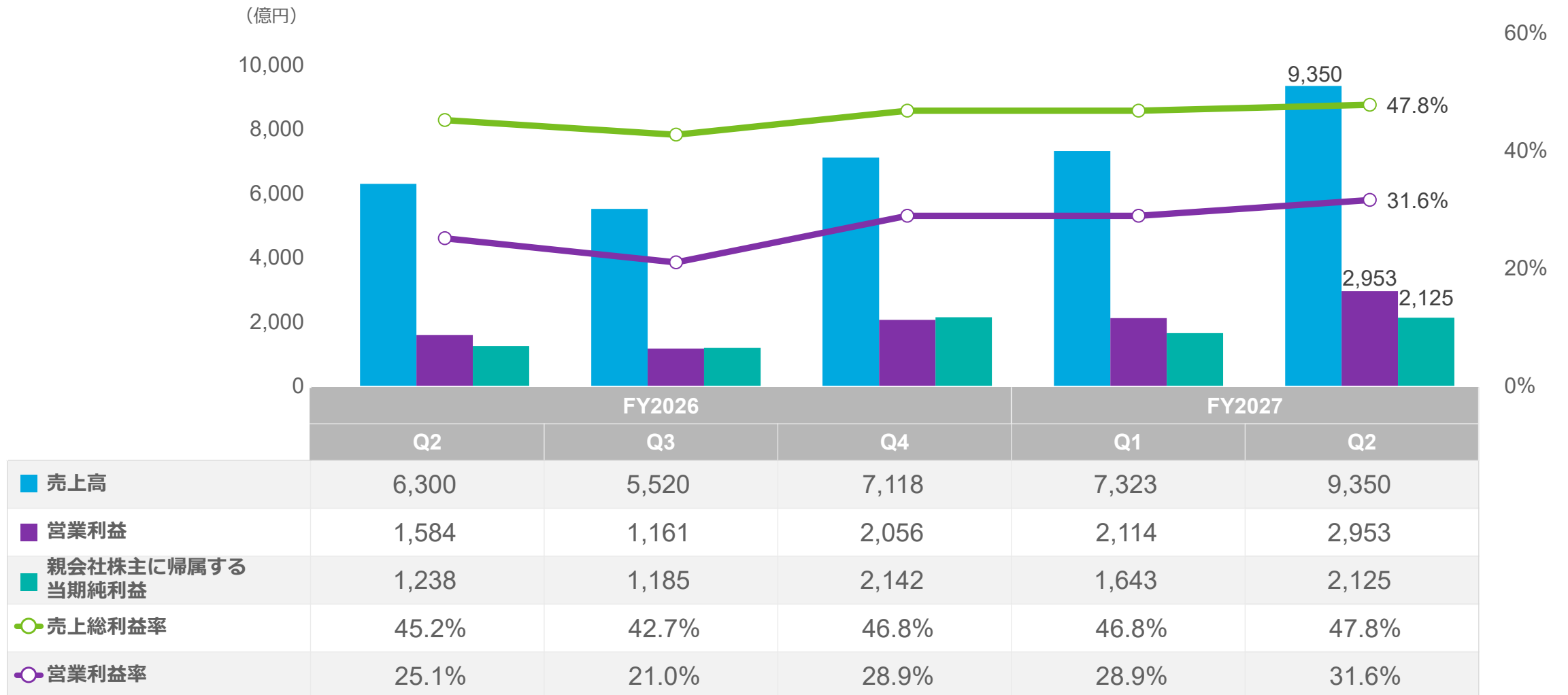
（億円）

	FY2026			FY2027		vs. FY2027 Q1	vs. FY2026 Q2
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
売上高	6,300	5,520	7,118	7,323	9,350	+27.7%	+48.4%
売上総利益	2,848	2,358	3,331	3,427	4,473	+30.5%	+57.0%
売上総利益率	45.2%	42.7%	46.8%	46.8%	47.8%	+1.0pts	+2.6pts
販管費	1,264	1,196	1,275	1,313	1,520	+15.8%	+20.2%
営業利益	1,584	1,161	2,056	2,114	2,953	+39.7%	+86.4%
営業利益率	25.1%	21.0%	28.9%	28.9%	31.6%	+2.7pts	+6.5pts
税金等調整前当期純利益	1,610	1,533	2,818	2,154	2,922	+35.6%	+81.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,238	1,185	2,142	1,643	2,125	+29.4%	+71.7%
研究開発費	726	662	767	720	852	+18.4%	+17.3%
設備投資額	912	303	416	399	323	-18.9%	-64.5%
減価償却費	191	211	235	225	243	+8.3%	+27.5%

1. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

2. FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。FY2027は2026年4月～2027年3月の会計年度を指しています。

損益状況（四半期）



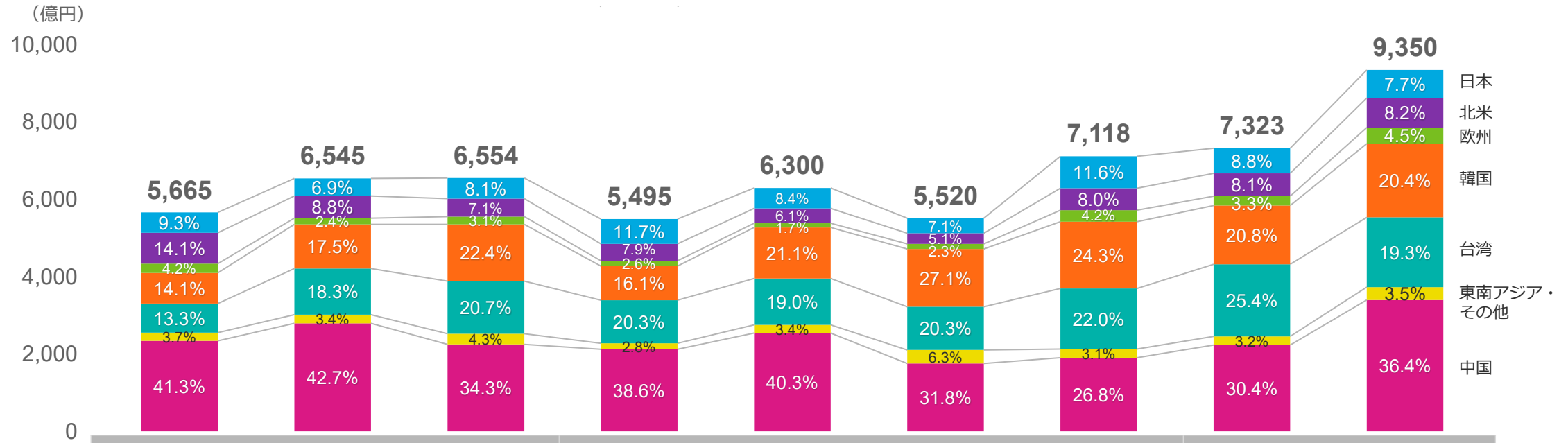
損益状況（半期）

（億円）

	FY2026		FY2027	vs. FY2026 H2	vs. FY2026 H1	(ご参考) 7月30日発表 FY2027 H1 予想
	H1	H2	H1			
売上高	11,796	12,638	16,674	+31.9%	+41.3%	16,200
売上総利益 売上総利益率	5,388 45.7%	5,690 45.0%	7,901 47.4%	+38.9% +2.4pts	+46.6% +1.7pts	7,480 46.2%
販管費	2,357	2,472	2,833	+14.6%	+20.2%	2,900
営業利益 営業利益率	3,031 25.7%	3,217 25.5%	5,067 30.4%	+57.5% +4.9pts	+67.2% +4.7pts	4,580 28.3%
税金等調整前当期純利益	3,129	4,351	5,077	+16.7%	+62.2%	4,640
親会社株主に帰属する当期純利益	2,416	3,328	3,769	+13.3%	+56.0%	3,490
研究開発費	1,348	1,430	1,573	+10.0%	+16.7%	1,600
設備投資額	1,440	719	723	+0.5%	-49.8%	-
減価償却費	362	447	468	+4.9%	+29.2%	-

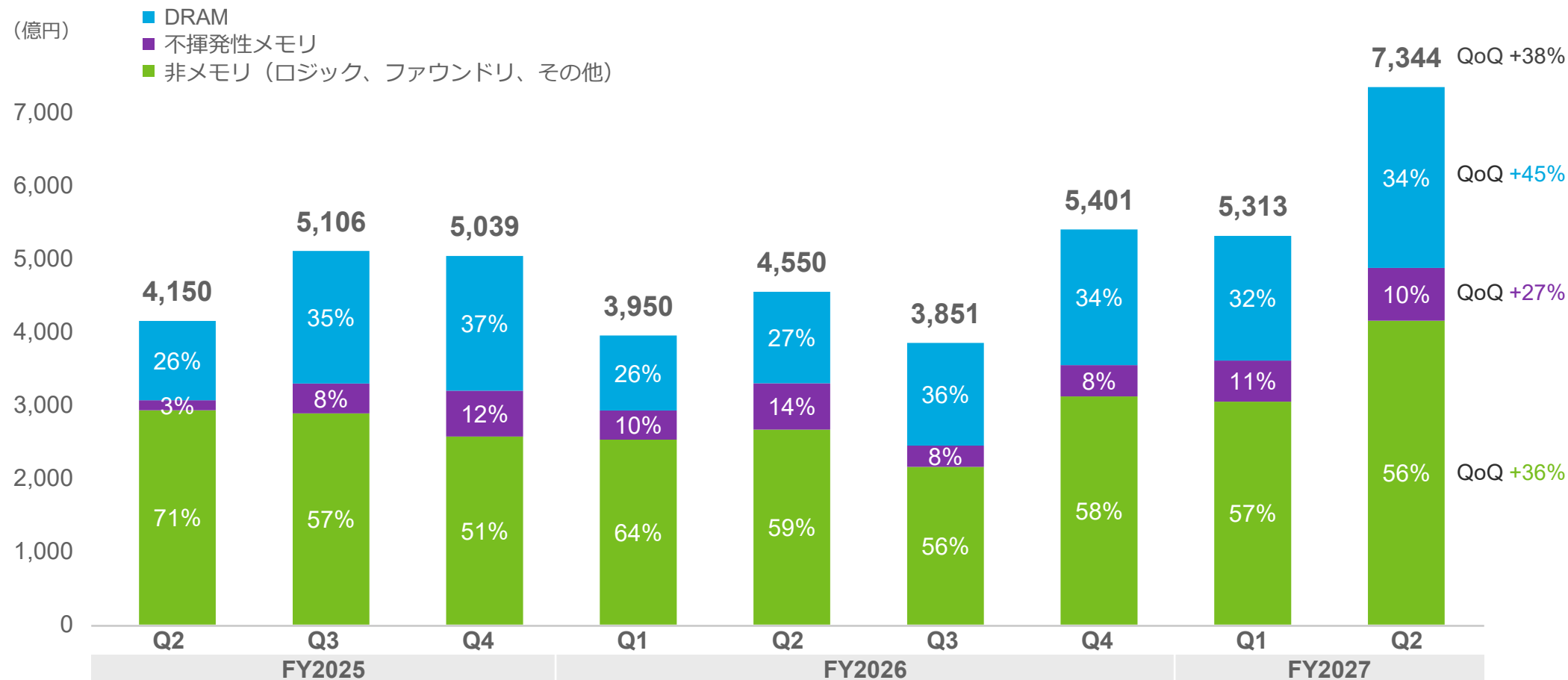
1. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

地域別売上高構成比（四半期）



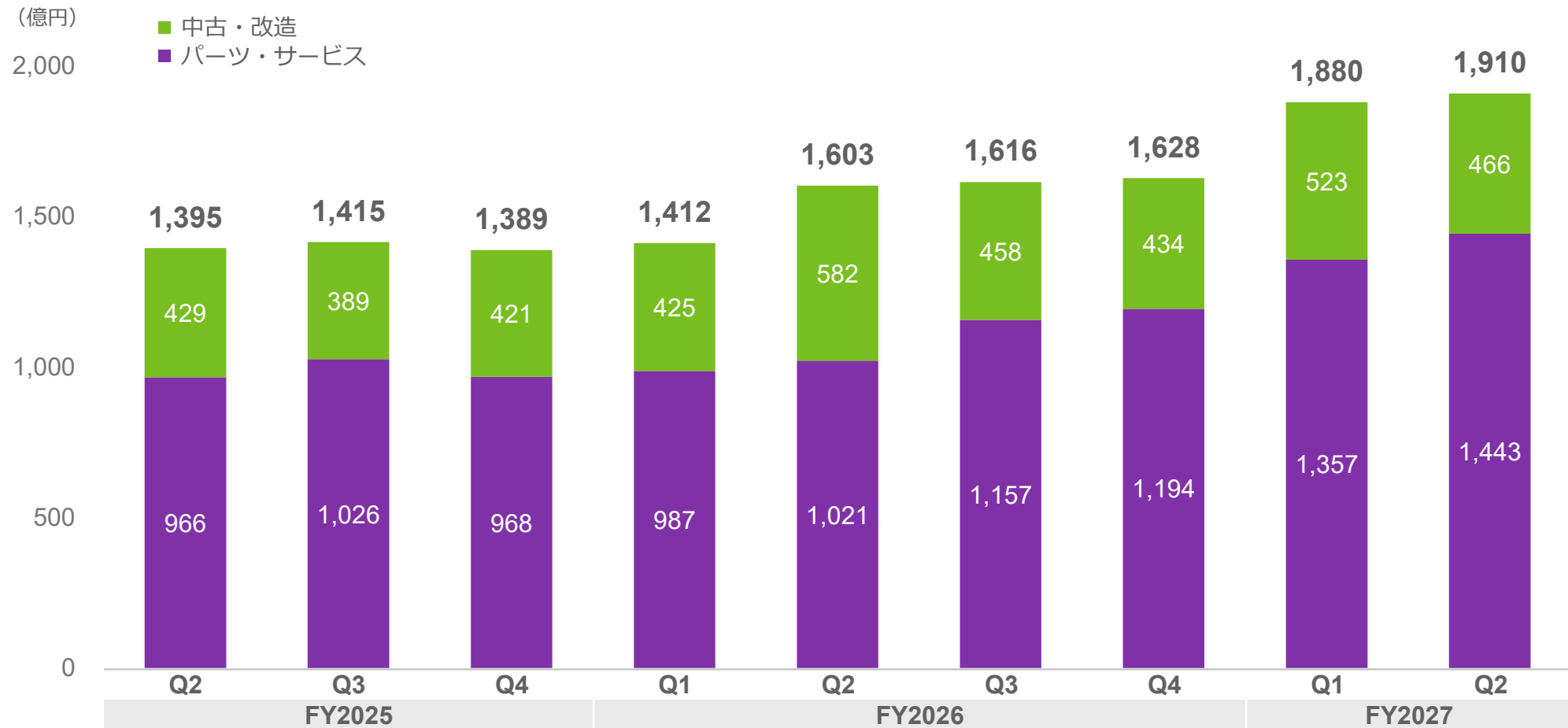
	FY2025			FY2026				FY2027	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
日本	526	453	534	643	529	393	828	646	722
北米	799	577	462	434	384	278	567	590	766
欧州	238	157	203	140	108	127	297	242	417
韓国	795	1,145	1,470	883	1,325	1,497	1,731	1,524	1,907
台湾	753	1,193	1,358	1,115	1,197	1,119	1,565	1,861	1,804
東南アジア・その他	212	223	278	156	213	348	221	229	332
中国	2,339	2,794	2,246	2,121	2,541	1,755	1,907	2,229	3,399

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



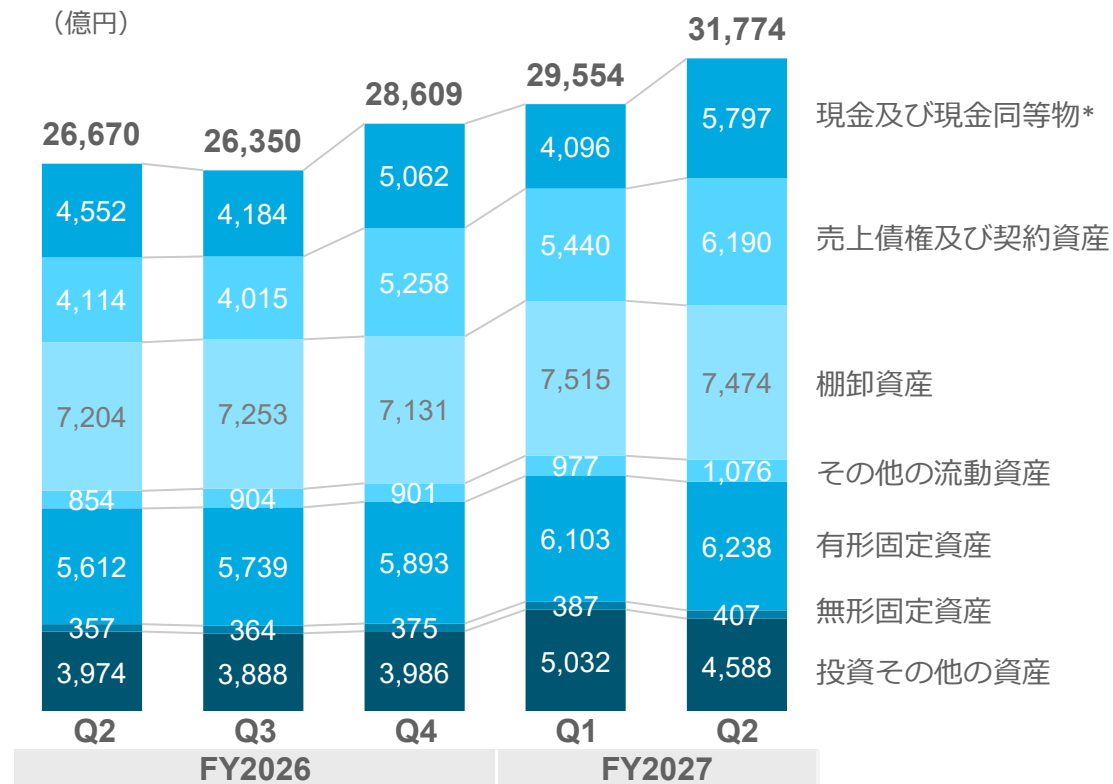
1. SPE（Semiconductor Production Equipment）：半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）

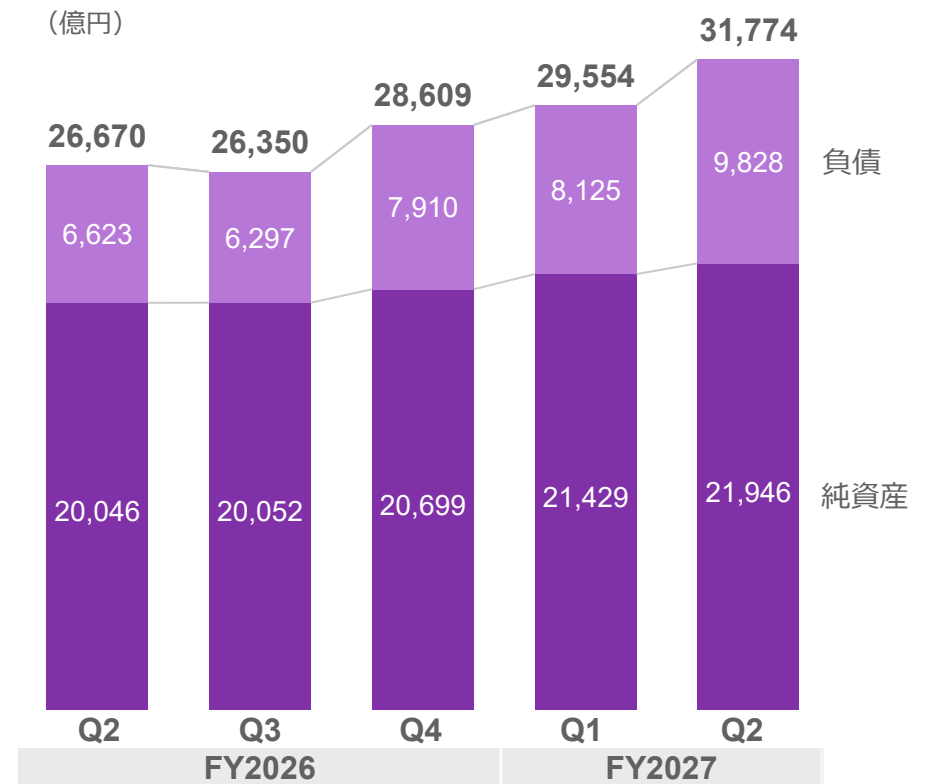


貸借対照表（四半期）

資産

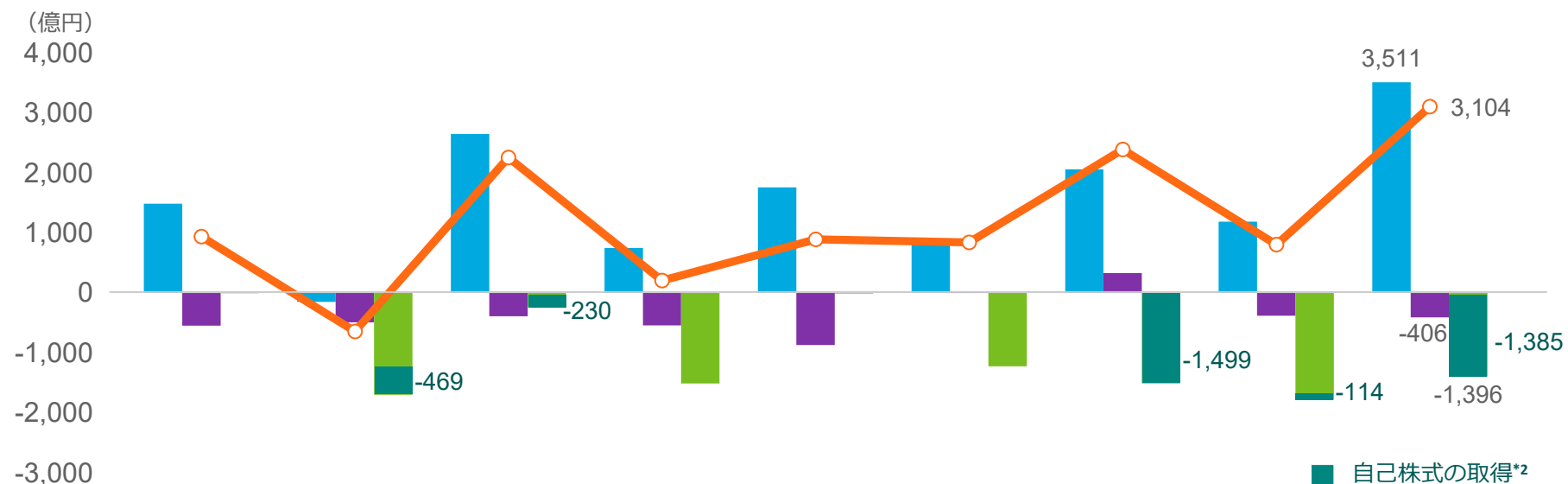


負債・純資産



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2025			FY2026				FY2027	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
■ 営業キャッシュ・フロー	1,486	-150	2,648	749	1,758	831	2,057	1,187	3,511
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-544	-490	-389	-541	-867	12	332	-381	-406
■ 財務キャッシュ・フロー	-6	-1,701	-235	-1,511	-10	-1,223	-1,508	-1,784	-1,396
○ フリーキャッシュ・フロー*3	941	-641	2,258	207	891	843	2,390	805	3,104
手元資金残高*4	5,255	2,955	4,962	3,675	4,552	4,184	5,062	4,096	5,797

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 自己株式の取得は、単元未満株式の買取りに要した金額を除いた金額です。

*3 フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*4 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

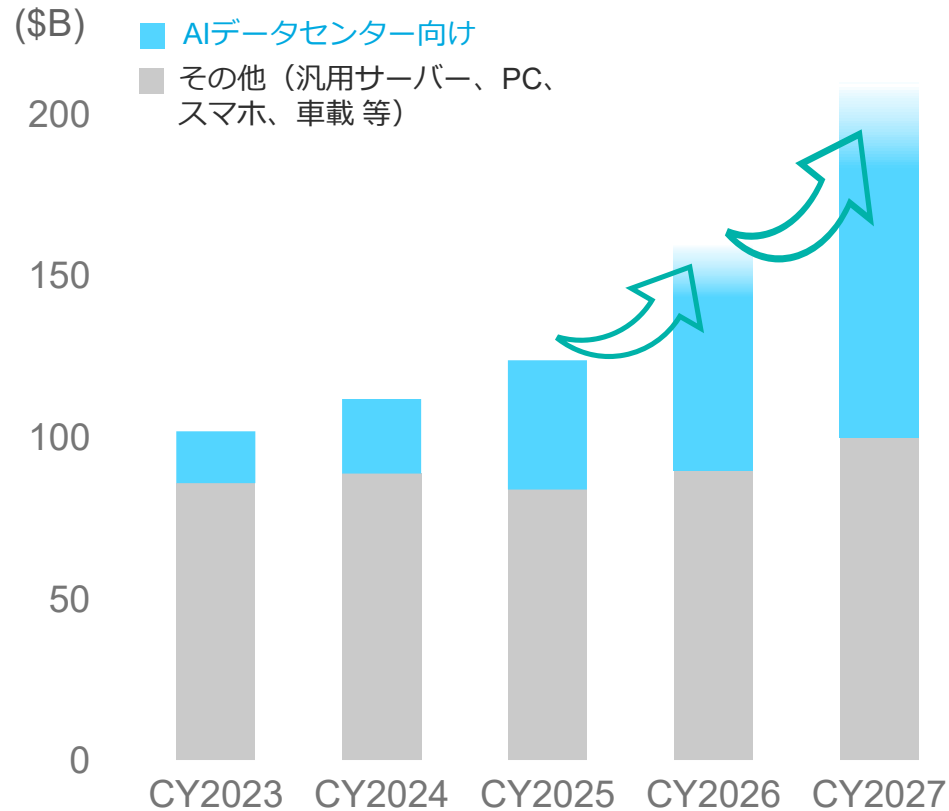
2026年10月30日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



事業環境（2026年10月時点でのWFE市場の見方）

WFE市場の推移



WFE市場の見通し

- CY2026：\$160B程度
- CY2027：\$210B以上
- 生成AIに加え、エージェント型AIの普及が、**先端半導体の需要拡大を加速**
 - **GPU/HBM**：演算量・データ量の増加に対応
 - **CPU**：演算の前処理やGPUへのデータ供給、周辺機器の制御などにより、必要数が増加
 - **DRAM**：CPU・GPU周辺で一時保存するデータの増加に伴い、必要容量が拡大
 - **NAND**：AIモデルや大規模データの保存により、サーバー当たりのストレージ容量が拡大

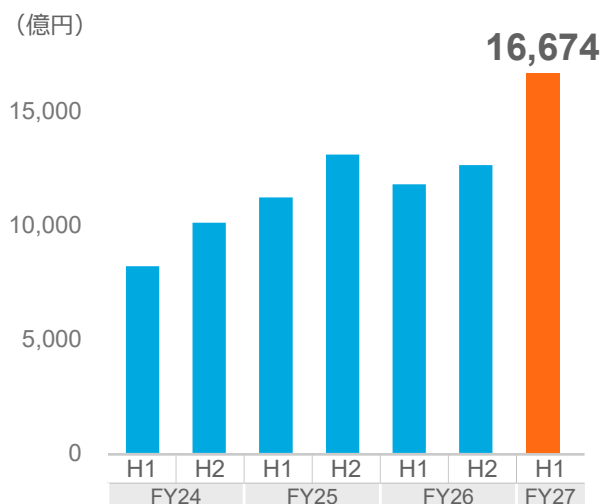
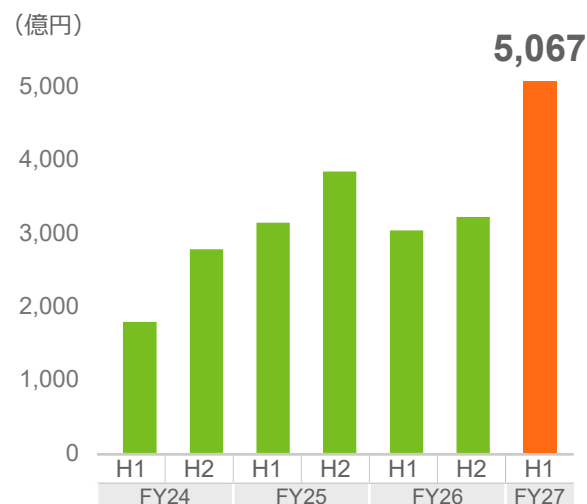
トークン量の増加・演算の複雑化が、AIインフラ全体の半導体需要を牽引

2027年3月期上期 事業概況

- 旺盛な需要を背景に、
半期で過去最高の業績を達成

売上高 1.6兆円

営業利益 5,067億円



- 塗布現像装置・洗浄装置ビジネスユニット：
熊本地方の震災影響に迅速に対応し、
上期売上高は前下期比 +50%超を達成



2027年3月期上期 事業進捗・製品展開

エッチング

DRAMキャパシタ マスク工程（コンダクタエッチング）

DRAM現行世代で広く採用されているキャパシタモールド（絶縁膜エッチング）に加え、先端世代でマスク工程のPOR*1を1社で獲得

NANDチャネルホール（絶縁膜エッチング）

極低温エッチング装置の量産受注が順調に進捗

成膜

コンタクトメタル（枚葉CVD）

最先端ロジックにおける新工程の開発POR獲得に成功

Deep Trench Capacitor High-k（バッチALD）

先端パッケージング向けで需要拡大。今期・来期とも200台以上の出荷を見込む

プローバ

先端ロジックシェアNo.1

増加するテスト需要を取り込み、**前期比約60%増**の記録的な**出荷台数**を見込む

PIC*2における、**光・電気統合テスト**も量産拡大

*1 POR: Process of Record

*2 PIC: Photonic Integrated Circuit



2027年3月期 業績予想

(億円)

	FY2026 (実績)	FY2027			
		H1 (実績)	H2 (予想)	通期 (予想)	vs FY2026
売上高	24,435	16,674	20,325	37,000	+51.4%
売上総利益	11,078	7,901	9,818	17,720	+59.9%
売上総利益率	45.3%	47.4%	48.3%	47.9%	+2.6pts
販管費	4,829	2,833	3,196	6,030	+24.9%
研究開発費	2,778	1,573	1,776	3,350	+20.6%
研究開発費以外の販管費	2,050	1,259	1,420	2,680	+30.7%
営業利益	6,249	5,067	6,622	11,690	+87.1%
営業利益率	25.6%	30.4%	32.6%	31.6%	+6.0pts
税金等調整前当期純利益	7,481	5,077	6,642	11,720	+56.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,744	3,769	4,880	8,650	+50.6%
1株当たり当期純利益 (円)	250.91	166.13		381.69	+130.78

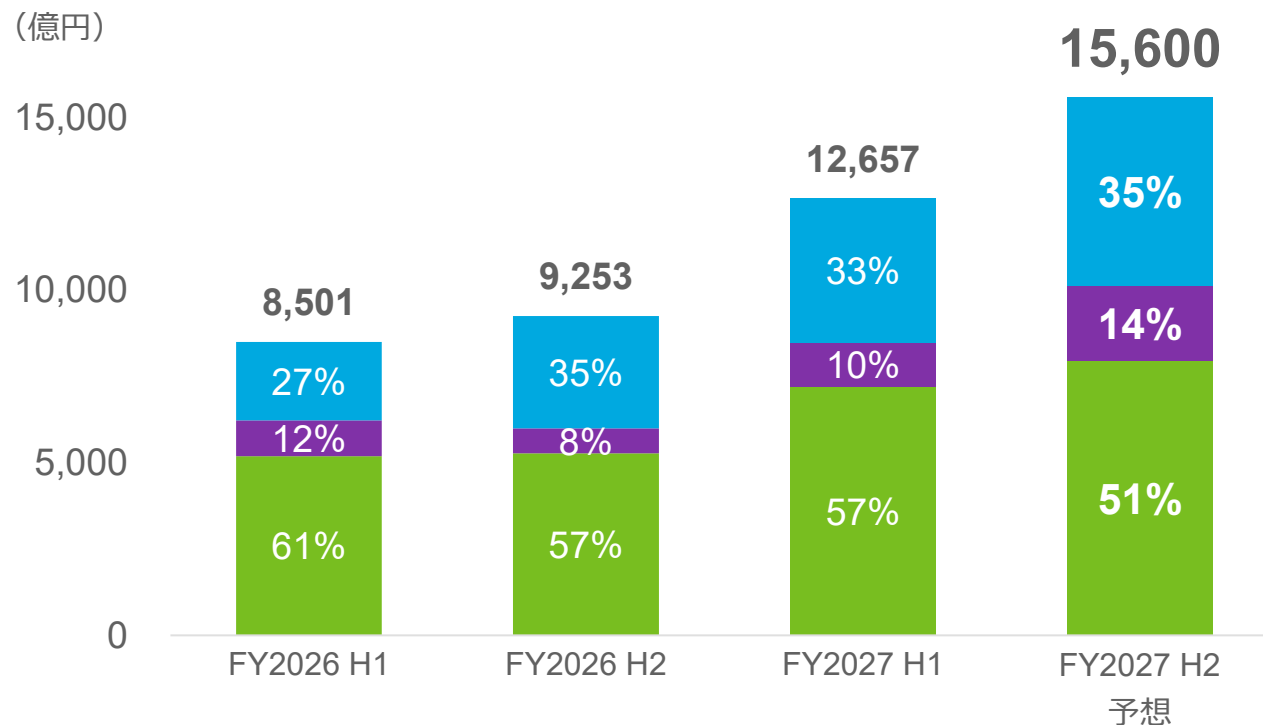
- 当社は2026年10月1日を効力発生日として1株を5株に株式分割しております。
- 1株当たり当期純利益は、FY2026の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。

FY2027通期予想は売上高・利益のすべてで過去最高を見込む

2027年3月期 SPE新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比

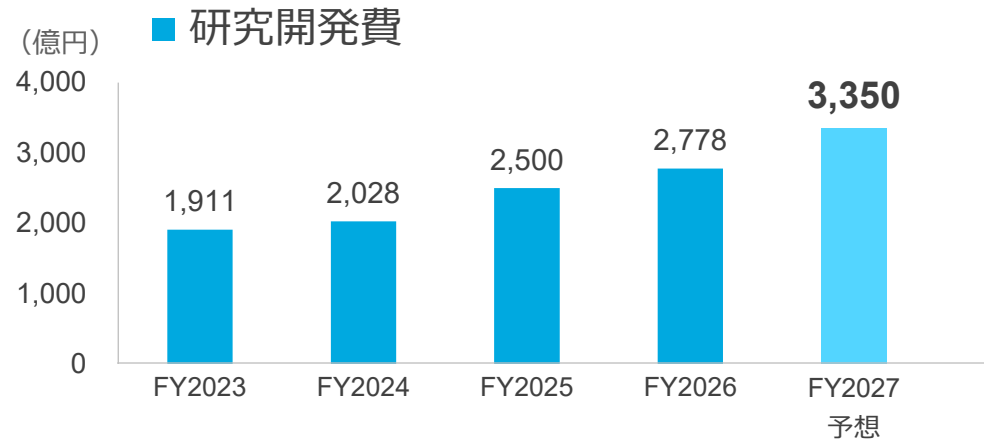
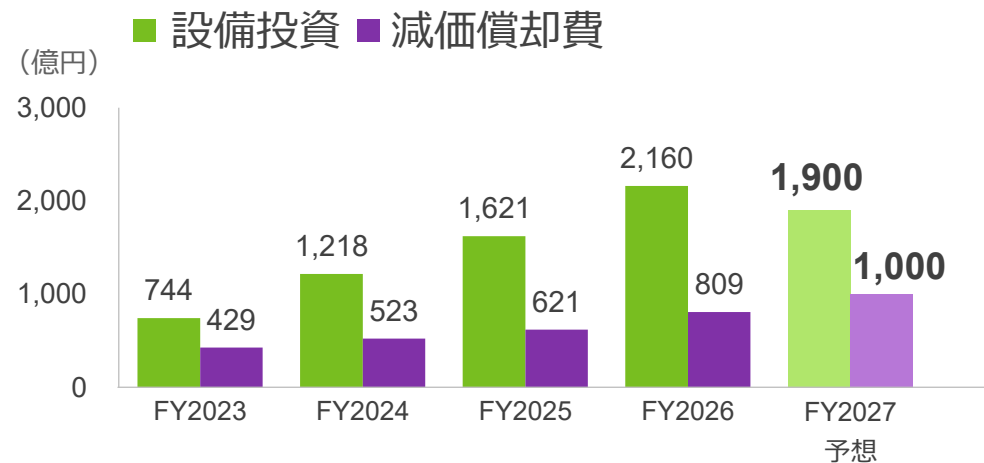
■ DRAM ■ 不揮発性メモリ ■ 非メモリ(ロジック、ファウンドリ、その他)



* グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

下期のSPE新規装置売上は1兆5,600億円を見込む
FY2027通期のSPE新規装置売上は前期比 +59%成長

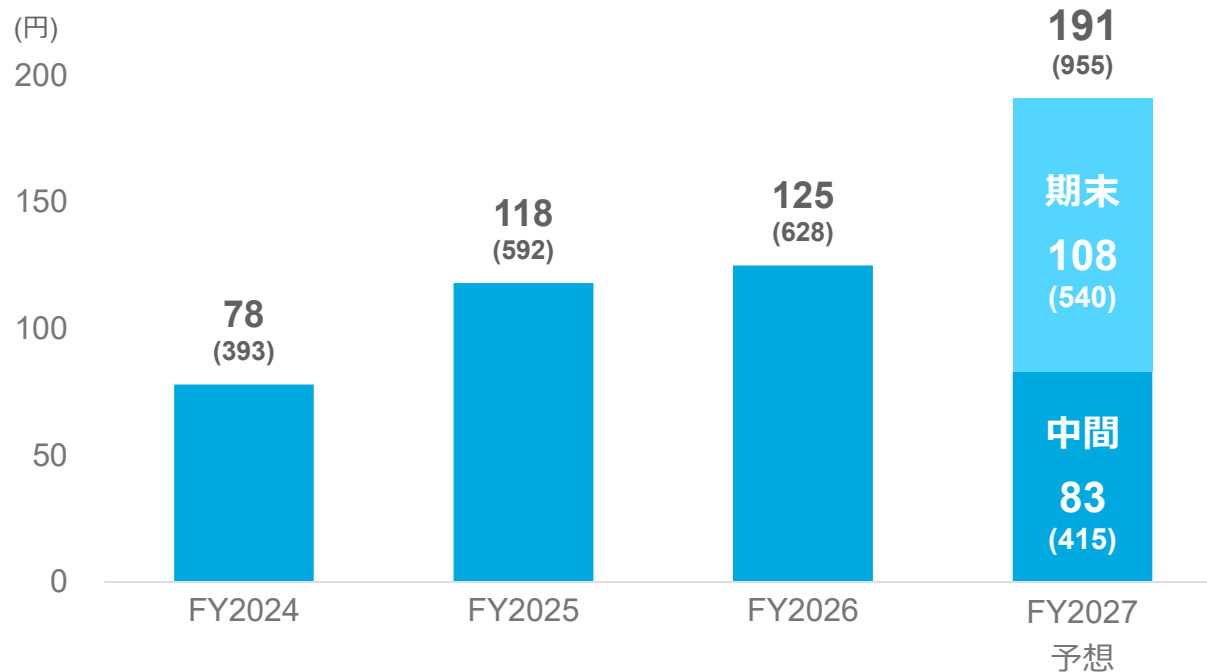
2027年3月期 研究開発費・設備投資計画



宮城県黒川郡大和町（2027年夏竣工予定）

2027年3月期 配当予想

1株当たり配当金



- 当社は2026年10月1日を効力発生日として1株を5株に株式分割しております。
- FY2024～2026の年間配当およびFY2027の中間配当の1株当たり配当金は、FY2024の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- 株式分割を考慮しない金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金10円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2026年10月1日付の株式分割により、従来の50円から変更しています。

1株当たり通期配当予想は過去最高の191円

自己株式の取得について

最大1,500億円の自己株式取得枠を設定

■ 取得対象株式の種類	当社普通株式
■ 取得し得る株式の総数	2,500万株（上限） （自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.1%）
■ 株式の取得価額の総額	1,500億円（上限）
■ 取得する期間	2026年11月1日～2027年3月31日

拡大する当社の事業機会とキャッシュ創出力、資本効率の向上を考慮し、
適切なバランスシート・マネジメントを実施



TOKYO ELECTRON

本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

TEL および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。